

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（）
参与单位名称	<u>2026年2月26日</u> 百年保险资管、博时基金、创金合信基金、东方基金、富国基金、国泰基金、华泰资管、南方基金、太平资管等
时间	2026年2月26日
调研方式	线上会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。基于自有的 IP，公司已拥有

丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。此外，根据 IPnest 在 2025 年的统计，从半导体 IP 销售收入角度，芯原是 2024 年中国大陆排名第一、全球排名第八的半导体 IP 授权服务提供商；2024 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的报告和企业公开数据，在全球排名前十的 IP 企业中，芯原的 IP 种类排名前二。

根据公司披露的《2025 年年度业绩快报公告》，公司 2025 年全年营业收入同比大幅增长，公司预计 2025 年度实现营业收入约 31.52 亿元，较 2024 年度增长 35.77%；2025 年下半年，公司预计实现营业收入 21.79 亿元，较 2025 年上半年增长 123.73%，较 2024 年下半年增长 56.75%。

单季度新签订单屡创新高，在手订单连续九个季度保持高位。公司技术能力业界领先，持续获得全球优质客户的认可，2025 年第二、第

	<p>三、第四季度新签订单金额分别为 11.82 亿元、15.93 亿元、27.11 亿元，单季度新签订单金额三次突破历史新高，其中 2025 年第四季度较第三季度进一步增长 70.17%。2025 年全年，公司新签订单金额 59.60 亿元，同比增长 103.41%，其中 AI 算力相关订单占比超 73%，数据处理领域订单占比超 50%。</p> <p>截至 2025 年末，公司在手订单金额达到 50.75 亿元，较三季度末的 32.86 亿元大幅提升 54.45%，且已连续九个季度保持高位。公司 2025 年末在手订单中，量产业务订单超 30 亿元，量产业务的规模效应显著，订单的持续转化将为公司未来盈利能力逐步提升奠定坚实基础。2025 年末在手订单中，预计一年内转化的比例超 80%，且近 60%为数据处理应用领域订单。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题：请问公司目前与互联网公司等系统厂商客户的合作情况如何？</p> <p>回复：近年来，互联网公司、云服务提供商、车企等系统厂商因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片，催生了对芯片定制服务的需求。芯原拥有先进的芯片定制技术、丰富的 IP 储备，延伸至软件和系统平台的设计能力，以及长期服务各类客户的经验积累，成为了系统厂商、互联网公司、云服务提供商和车企首选的芯片设计服务合作伙伴之一。2025 年前三季度，来自上述系统厂商客户的收入占比 40.36%；截至三季度末，公司在手订单中 83.52%来自于上述系统厂商客户。</p> <p>问题：请问公司在为客户提供定制服务过程中，是否会采用公司自有的半导体 IP？</p> <p>回复：公司的一站式芯片定制服务和 IP 授权业务存在很强的协同</p>

性，公司在为客户提供一站式芯片定制业务的过程中，IP 的选型很大程度上决定了芯片的性能和功耗，因此对于客户而言，在一站式芯片定制业务中使用芯原自有 IP 在成本和设计效率等方面更具优势。另一方面，公司在为客户提供半导体 IP 授权服务的过程中，优质的 IP 和服务逐步受到客户认可。当客户出现新的芯片定制需求时，基于已有合作基础，会优先考虑采用芯原的一站式芯片定制服务。

问题：海内外算力硬件需求持续增长，公司将如何把握这一行业机遇实现自身发展？

回复：因算法较为复杂和需要进行海量数据处理，AIGC 模型在云侧进行训练和推理，以及在端侧进行微调和推理时，产生了很大的算力需求。AI ASIC 凭借其定制化架构、高计算密度和低功耗特性，可以在特定场景中实现高性价比和低功耗，正在成为高效 AI 计算的刚需选项，尤其在超大规模数据中心、实时边缘推理及车载系统领域增长迅速。

作为“AI ASIC 龙头企业”，芯原在云端算力（训练和推理）芯片定制领域已建立起显著优势；面向未来，公司将在持续服务数据中心、高性能计算等市场需求的同时，大力拓展端侧 AI 市场，为端侧 AI 微调和推理提供高效的算力支持。2025 年全年，公司新签订单金额 59.60 亿元，同比增长 103.41%，其中 AI 算力相关订单占比超 73%，预计未来 AI 算力相关领域的客户需求将驱动公司业绩增长。

问题：近年来端侧 AI 场景需求增长，请问公司有哪些布局和客户成果？

回复：基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖数据中心、服务器等高性能云侧计算设备以及实时在线、超低能耗的端侧设备；不仅在 AI PC、AI 手机

等存量市场，而且在 AI 眼镜、AI 玩具、AI Pad 等增量市场开发更先进的核心 IP，打造更完整的芯片设计平台。

目前，公司已为某知名新能源汽车厂商提供全球领先的基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务，实现一次流片成功，并且正在积极推进智慧出行领域 Chiplet 解决方案。针对快速发展的 AI 端侧应用，芯原与谷歌基于之前 Open Se Cura 开源项目合作基础，共同打造了面向端侧大语言模型应用、基于 RISC-V 指令集的超低能耗 Coral NPU IP；其中，谷歌提供开源技术，芯原提供企业级 IP、芯片设计及量产服务，为 AI 眼镜等“始终在线”、超低能耗、超轻量可穿戴设备、AI Pad、AI 玩具等提供端侧 AI ASIC 的解决方案。